2023年10月吉日

DEIM2024産学連携委員会

委員長　　　西村和哉(NTTデータ)

副委員長　　董 于洋(NEC)

**DEIM2024スポンサー募集**

DEIM2024のスポンサー企業・団体の募集をご案内いたします。本大会の成功と学術の振興のため、ご協力を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム (DEIM) は、データ工学と情報マネジメントに関する様々な研究テーマの討論・意見交換を目的としたワークショップです。2022年までの数年間は新型コロナウィルスによる感染拡大の可能性を考慮し、完全オンライン形式で開催しておりましたが、DEIM2023では、withコロナ時代の新たな試みとして「直列ハイブリッド形式」で開催し、オフラインで熱い議論が交わされました。

DEIM2024においても一般発表（1日目〜3日目）をオンラインで、その後オフライン会場に集まり、4日目と5日目はチュートリアルやポスター発表を中心として議論を交わします。運営一同、ポストコロナ時代の学術会議のあるべき姿を模索しながら準備を進めてまいります。

**<DEIM2024開催概要>**

【名称】

第16回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム（DEIM2024）

（第22回日本データベース学会年次大会）

【主催】

日本データベース学会

電子情報通信学会 データ工学研究専門委員会

情報処理学会 データベースシステム研究会

【Webページ】

<https://confit.atlas.jp/guide/event/deim2024/top?lang=ja>

【開催期日】

2024年2月28日（水）〜3月5日（火）

* 3月2日(土)と3日(日)は休み（移動日）

【開催形態】

直列ハイブリッド形式

2月28日〜3月1日：オンライン開催

3月4日、5日：現地開催（アクリエひめじ）

DEIM2024の協賛プランは、「プラチナ」「ゴールド」「シルバー」の3つのプランを用意しております。また、日本データベース学会（DBSJ）の活動を常日頃からご支援いただいているDBSJ維持会員各位には、協賛金の割引をいたします。特典の内容については、下記をご覧ください。本大会の成功と学術の振興のため、ご協力を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

なお、お申し込み多数の場合には、一部の特典をご提供できない可能性がございます（先着順とさせていただきます）。上限数はプログラム編成や会場の制約、COVID-19等感染症の情勢や必要な対策等に応じて変動する可能性がございます。また、COVID-19等の感染拡大の状況によっては、現地での特典をご提供できない可能性もございます。あらかじめご了承いただけますと幸いです。お早めのお申し込みをお願い申し上げます。特典の詳細は、お申し込み後に改めてご案内いたします。

スポンサー申し込みの締め切りは特にございませんが、1月10日を過ぎますと技術報告の枠が取れない可能性がありますので、それまでの申し込みを推奨しております。また、ランチョンセミナーを希望される場合は、遅くとも12月15日(金)までに、少なくとも関心がある旨を産学連携担当までご連絡ください。

協賛の実施について、ご検討くださいますよう、なにとぞお願い申し上げます。

1. 協賛プラン

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 協賛特典※1 | プラチナ40万円(税込)※2 | ゴールド20万円(税込)※2 | シルバー5万円(税込)※2 |
| 1 | ロゴ掲載 (Webページ・バーチャル背景) | 大 | 中 | 小 |
| 2 | 現地での常設ブース等の設置 ※3 | ○ | ○ | --- |
| 3 | 技術報告への登壇※4 | 1枠 | 1枠 | --- |
| 4 | スポンサー賞の授与 | ○ | --- | --- |
| 5 | 現地ランチョンセミナーの開催権（限定4枠）※5 | ○ | --- | --- |
| 6 | （調整中）会議ポータルへのコンテンツ掲載(動画・テキスト・ハイパーリンクなど) ※6 | ○ | ○ | ○ |

※1 DEIM2024への参加費は別途お支払いをお願いいたします。

※2 DBSJ維持会員には、協賛金の割引(20%)をご提供いたします。是非この機会にご入会をご検討ください（DBSJ維持会員について <https://dbsj.org/overview/sponsor/> ）。

※3 会場都合により特典の上限数に達した場合は先着順とさせていただきます。なお、設置場所についてはプラチナプランのスポンサー様を優遇いたします。

※4 プログラム編成の都合により特典の上限数に達した場合は先着順とさせていただきます。

※5 開催権の行使にあたり追加費用を別途申し受けます。この追加費用には弁当手配費用が含まれる予定で、手配はDEIM実行委員会にて実施いたします。金額は現在関連業者と調整中です。興味がある場合、産学連携までお問合せください。

※6 ポータルサイトの内容について現在調整中のため、確実な実施をお約束はできませんが、実施する方向で調整中です。

* 1. 募集要項

ご協賛いただくスポンサー様は、DBSJ/DEIMで対象とするデータ工学および情報マネジメントに関わる技術をサービスや製品の開発にご活用されている、もしくはこれら分野の研究に取り組まれていることを原則といたします。

* 1. 協賛プランのポイント

DEIM2024では、昨年度に引き続きより多くの露出機会を持っていただくことに注力いたします。また、例年好評をいただいている「技術報告への登壇」はオンラインでの開催とし、より多くの参加者に聴講されるようにいたします。万が一、COVID-19等の感染拡大の状況により、現地での露出機会をご提供できない場合には、次回（DEIM2025）の協賛金割引など、ご協賛いただくスポンサー様に十分なメリットをご提供できるように配慮いたします。

**多くの露出機会**

すべてのプランで「スポンサーロゴの掲載」、ゴールドプラン以上で「技術報告への登壇」「現地での常設ブースの設置」、プラチナプランで「スポンサー賞の授与」「ランチョンセミナーの開催権」をご利用可能となります。参加者への露出機会の増加に是非ご活用ください。

**テクノロジーショーケースとしての技術報告**

技術報告は、各社の先駆的な取り組みの紹介や技術力のアピールなど、各社のテクノロジーショーケースとしてご好評いただいております。

**スポンサー賞授与を通じた学生による優れた研究活動の奨励**

DEIM2023でもご好評いただいたスポンサー賞を、引き続き設定いたします。スポンサー様のそれぞれの視点で選考していただくスポンサー賞は、学生の研究活動に大きな励みとなることが期待されます。是非、スポンサー様それぞれのオリジナリティあふれる副賞とともに、学生による優れた研究活動をご奨励ください。スポンサー賞はプラチナプランでご利用可能です。

**スポンサー企業・団体間でのノウハウやプラクティスの共有**

産学連携の強化のため、スポンサー賞など新しい試みに挑戦しております。ハイブリッド形式、オンライン形式の学会参加、協賛に不慣れなスポンサー様や、新たにDEIMへの協賛をご検討くださっているスポンサー様にも協賛特典を有効活用していただくべく、スポンサー間でノウハウやプラクティスを共有する場を、DEIM2023に引き続き設けます。スポンサー間のつながりやコミュニティ作りの一助となれば幸いです。

1. 特典について
	1. ロゴ掲載

　DEIM2024のWebページと、オンラインミーティング用のバーチャル背景画像にロゴを掲載します。

DEIM2024のWebページには、ご希望のリンク先へのリンクを張ったロゴを掲載します。ロゴの大きさは協賛プランによって異なります。同じプラン内での掲載順は申し込み順を予定しております（変更の可能性あり）。

　（ご参考）DEIM2023のロゴ掲載：<https://event.dbsj.org/deim2023/>

　バーチャル背景画像は、実行委員等がオンラインミーティング時にバーチャル背景として利用します。バーチャル背景へのロゴ掲載順は、同じ協賛プランの種別毎にお申し込み順とします。

　（ご参考）DEIM 2023で配布した背景画像

<https://event.dbsj.org/deim2023/img/deim2023_background.png>

　ロゴのご提出方法については、お申し込み後にご連絡させていただきます。

* 1. 常設ブースの設置 (現地会場)

　DEIM2024の現地会場に、常設ブースを設置いたします。本特典は「プラチナ」「ゴールド」プランのみに提供します。

　常設ブースはアクリエひめじで行われるポスター発表の会場に設置されます。設置期間は、オフライン期間2日間のうち1日目の午後いっぱいと2日目の午前から夕方までの約1日半を予定しております。この1日半のうち、75%の時間帯では同じ会場でポスター発表が実施されている予定ですので、多くの学会参加者がブースにも足を運ぶと期待できます。

　「プラチナ」プランのスポンサー様に「ゴールド」プランのスポンサー様よりも目立つ場所にスペースを提供したいと考えております。また、可能な限り多くのスポンサー様にブースを設置いただけるよう検討してまいります。ただし、ブース設置のお申し込み多数の場合は、上位スポンサー様優先および先着順とし、上限に達した場合にはお申し込みを打ち切る場合がございます。スポンサー数、会場や感染症対策の制約によって、スペース提供の形態に若干の変更が生じる可能性もございますことをご承知おきください。

　なお、COVID-19等感染症の状況に応じて、完全オンライン開催へと変更となった場合には、会議ポータル内でのコンテンツ掲載のみとなります。このとき、掲載コンテンツへの参加者の誘導ならびに盛り上げ施策を追加で検討いたします。

　ブースのイメージ画像は下記となります。昨年度のゴールドスポンサーブースの一例です。プラチナスポンサーはこの二倍の大きさのブースとしておりました。

　現地会場に設置するブースのサイズ・設営方法については，後日ご連絡いたします。

* 1. 技術報告への登壇

　DEIM2024のオンラインでの口頭研究発表セッション内でスポンサー様の先駆的な取り組みの紹介や技術力のアピール等を実施いただける技術報告への登壇の権利を「プラチナ」「ゴールド」プランに提供します。

　**技術報告でご発表いただく内容は、スポンサー様独自の技術的なコンテンツに限ります。学術会議であるDEIM2024のセッション内でご発表いただくという観点からもご配慮願います。**

昨年度の各社発表内容（タイトル）は、昨年度のプログラムからご参照ください。

　　<https://deim-management-system.github.io/deim2023_program/index.html#presen>

　　（ページ内で「技術報告」で検索してください）

　発表時間は、DEIM2024の論文発表に準じます。ご発表の題目とご発表者のお名前を、論文発表と同様にプログラムに掲載します。ご発表のセッションは、ご希望をお伺いした上で検討しますが、ご希望に添えない場合もございますことをご承知おきください。

　なお、技術報告にご登壇いただく方にも、DEIM2024への参加登録を別途お願いしております。技術報告でのご発表だけでなく、セッションへの参加や参加者との交流を通して、DEIM2024を盛り上げていただければ幸いです。

* 1. スポンサー賞の授与

　スポンサー様独自のご見識に基づいて、学生の研究活動を奨励していただくことを目的とした、スポンサー賞の授与権を提供します。本特典は「プラチナ」プランにのみ提供します。

　スポンサー賞の選定対象は、DEIM2024で発表された学生を筆頭著者とする研究発表です。スポンサー様ごとに、授与の候補となる発表をいくつか選定していただきます。最終的な授与対象は、多くの学生の発表を奨励する観点から、産学連携委員とスポンサー賞の授与を希望するスポンサー様とを含むメンバーで協議の上で決定いたします。選定の方法や協議の方法についてはDEIM2024開催までにご連絡いたします。

　また、副賞の授与をしていただくことも可能です。副賞は各スポンサー様でご用意ください。なお、受賞者間の公平性という観点から、市価10万円（税別）を超えるような高価な副賞はご遠慮いただくようお願いいたします。

ご参考までに、過去に受賞した学生から喜ばれた副賞の事例を以下に示します。

* **今後の研究に活用できるもの**

ディープラーニングの研究をしている学生などを念頭に、GPGPUカードなどを贈呈

* **研究室の全員で楽しんでいただけるデバイス**

研究室の飲み会や旅行などで活用していただけるデバイス（360°カメラなど）を贈呈

* **強いメッセージ性のある副賞**

「研究を頑張ってほしい」という意味を込めて、「エナジードリンク1年分」などの賞品を贈呈

* **入手の心理的ハードルが高いデバイス**

Kickstarterでしか買えないVR系デバイスやドローンなどを贈呈

* **特別な機会の提供**

賞品ではなく、オフィス見学へのご招待やキーパーソーンの方とのお食事など、学生が普段なかなか得られない機会を副賞として提供

* 1. ランチョンセミナーの開催権

　スポンサー独自のランチョンセミナーを開催する権利を先着4社・団体様にご提供します。本特典は「プラチナ」プランにのみ提供し、追加の費用を申し受けます。この追加費用はセミナーで提供する昼食（お弁当）の費用を含みます。費用は昼食業者と調整中です。興味のある企業様は産学連携委員までお問い合わせください。

　ランチョンセミナーでは、スポンサー様独自のイベントや講演を開催していただくことができます。技術報告とは異なり、技術的なコンテンツに限定をいたしません。

　開催する時間帯は、学会4日目（オフライン1日目）のお昼を予定しております。詳細な開催の時間帯や開催方式については、COVID-19等感染症の状況を鑑みて、後日ご連絡させていただきます。

　ランチョンセミナーを希望される場合、遅くとも12月15日(金)までに、少なくとも関心がある旨を産学連携委員までお申し出ください。

* 1. 会議ポータルへのコンテンツ掲載

　DEIM2024の全参加者がログインする会議ポータルに、各種オンラインコンテンツ（動画、テキスト、ハイパーリンクなど）を掲載いただけます。常設ブースや技術報告などの内容の事前ご案内、スポンサー様の技術力アピールなどに、ぜひご活用ください。

　こちら、実施有無を現在調整中ですが、実施する方向で考えております。

1. お申し込み方法

　お申し込みは、下記googleフォームからお願いいたします。

　　<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrfGq0xcRIcOFkUW2oCwKMBzA2-IDF0cHsZN9pfkbozHxFYw/viewform?usp=sf_link>

googleフォームでの申し込みが難しい場合、別紙「DEIM2024ご協賛お申し込みフォーム」にご記入の上、下記連絡先までメールでお申し込みください。

連絡先：< deim2024-kyousan@googlegroups.com >

　協賛金のお支払い方法については、後日、ご担当者様にご連絡いたします。

1. 問合せ先

　ご不明点やご質問などございましたら、下記までお気軽にご連絡ください。

　　　連絡先：< deim2024-kyousan@googlegroups.com >

　なお、DEIM2024のスポンサー様を含む、企業間の交流（ノウハウやプラクティスの共有）を目的としたSlackを試験的に開設しております。お申し込みいただいたスポンサー様、あるいはお申し込みを検討しておられる企業のご担当者様または関係者様をご招待させていただきます。DEIM2023以前のスポンサーの皆様もおられますので、ぜひ交流を深めていただければと存じます。

以上

参考資料

前回大会(DEIM2023)スポンサー企業

■プラチナスポンサー

株式会社日立製作所

株式会社リクルート

株式会社Scalar

合同会社DMM.com

アマゾンウェブサービスジャパン合同会社

LINE株式会社

　日本電気株式会社

　株式会社LayerX

■ゴールドスポンサー

株式会社東芝

株式会社NTTデータ

株式会社LIFULL

株式会社LegalOn Technologies

株式会社Gunosy

富士通株式会社

　ヤフー株式会社

ウォンテッドリー株式会社

　楽天グループ株式会社

■シルバースポンサー

　株式会社i-plug

issin株式会社